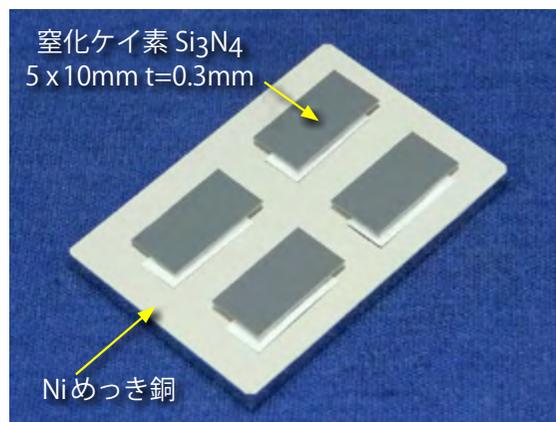




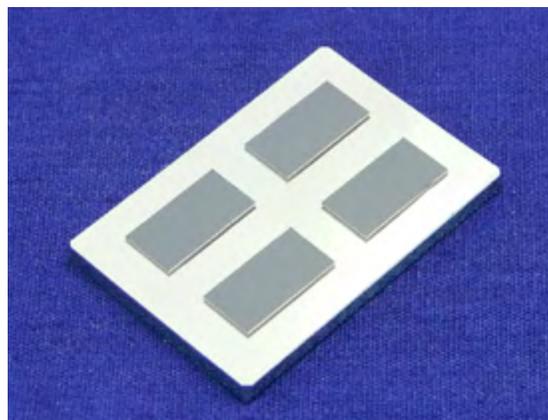
SoundBonding application



〈セラミックス基板とヒートシンクの
ダメージのない異材料間一括接合〉



接合前



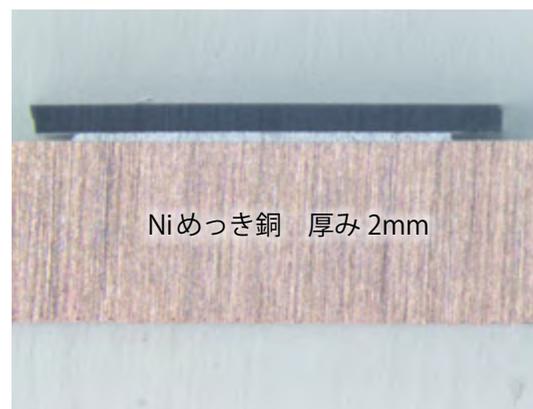
接合後



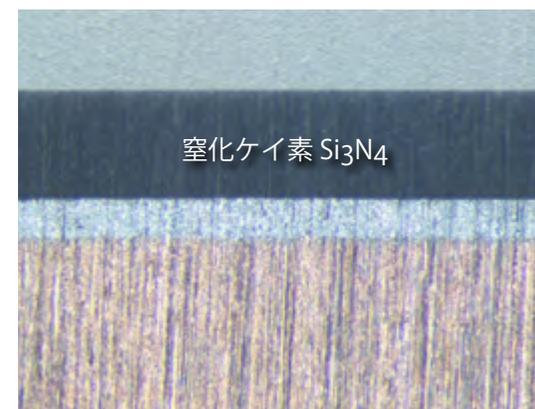
折り曲げて接合強度を確認



- ★窒化ケイ素基板とNiめっき銅製ヒートシンクの異材料間接合
- ★4個のセラミックス基板を一括同時接合
- ★ヒートショックテストクリア (-50 ~ 600°C)
- ★音エネルギーのみで接合
- ★大気中常温接合
- ★接合のエネルギー源は電気とエア
- ★デスクトップ接合



接合断面観察



接合部拡大

SoundPower[®]
Laboratory

ULTEX[®]